

<オンラインセミナー>

「カーボンニュートラル時代の半導体熱設計」

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は、当協会の諸事業に対しまして格別のご高配を賜わり厚く御礼申し上げます。

さて、半導体構造設計技術サブコミッティ（SC）では、カーボンニュートラル時代の半導体熱設計手法として、半導体パッケージの熱モデルの標準化活動を進めております。

今般、「カーボンニュートラル時代の半導体熱設計」と題するセミナーを企画し、機器の電動化においてなくてはならない「パワー半導体モジュール」や放熱機構として高く注目されている「ヒートパイプ、ベイパーチャンバ」について、特別講演としてお話しを頂くとともに、半導体構造設計技術 SC／熱設計技術 WG における取り組みなどを紹介させて頂くことと致しました。

つきましては、この機会にぜひご参加頂き、各社の事業戦略・標準化戦略の立案に役立てて頂くとともに、ご興味がございましたら同 SC への参画もご検討頂けますと幸いに存じます。

敬具

【開催概要】

日 時 : 2024 年 3 月 29 日 (金) 13:30~17:00

開催方法 : Webex によるリモート開催

主 催 : 一般社団法人電子情報技術産業協会
半導体標準化専門委員会／半導体システムソリューション技術委員会
半導体構造設計技術サブコミッティ（SC）／熱設計技術 WG

参加費 : 無料

申込方法 : 下記サイトよりお申し込み下さい。

<https://www.jeita.or.jp/form/custom/333/form>

お申し込み後、ご登録頂いたメールアドレス宛に Webex への参加用のミーティングリンクをご案内させていただきます。

申込期限 : 2024 年 3 月 22 日 (金) までにお申し込みください。

プログラム：

時間	内容
13:30 - 13:40	開会挨拶・趣旨説明
	西 剛伺 半導体構造設計技術 SC/熱設計技術 WG 主査
13:40 - 14:00	半導体構造設計技術 SC の活動紹介
	吉田 浩芳 半導体構造設計技術 SC 主査
14:00 - 14:50	<特別講演 1 > パワー半導体モジュールにおけるパッケージ技術と熱設計
	池田 良成 氏 富士電機株式会社 半導体事業本部 開発統括部
14:50 - 15:20	熱設計技術 WG 活動紹介 1
	熊野 豊、武井 春樹 半導体構造設計技術 SC/熱設計技術 WG 委員
15:20 - 15:40	休憩
15:40 - 16:30	<特別講演 2 > ヒートパイプとベーパーチャンバを用いた電子機器冷却
	齋藤 祐士 氏 株式会社フジクラ 電子部品・コネクタ事業部門
16:30 - 16:50	熱設計技術 WG 活動紹介 2
	羽鳥 仁人 半導体構造設計技術 SC/熱設計技術 WG 委員
16:50 - 17:00	閉会挨拶
	西 剛伺 半導体構造設計技術 SC/熱設計技術 WG 主査

※プログラムは、都合により変更になる場合があります。予めご了承ください。

■運営事務局・各種お問合せ先

一般社団法人電子情報技術産業協会

事業戦略本部 事業推進部 担当：岩淵・遠山

〒100-0004 東京都千代田区大手町1丁目1番3号 大手センタービル 4階

E-mail : device3@jeita.or.jp

■個人情報保護について

※お申込み頂いた皆様の個人情報は、本セミナーの受付をはじめ、JEITA 主催セミナーのご案内、セミナーアンケートでの質疑回答のために使用致します。

これらの目的以外で使用することはございません。

※JEITA の個人情報保護方針につきましては下記をご参照ください。

<http://www.jeita.or.jp/japanese/privacy/>

以 上